

2009年度砥粒加工学会学術講演会(ABTEC2009)講演募集について

[砥粒加工学会 ABTEC2009 実行委員会]

1. 期 間：平成21年9月2日(水), 3日(木), 4日(金)
2. 会 場：ものづくり大学 技能工芸学部 〒361-0038 埼玉県行田市前谷 333 番地
ものづくり大学の詳細は、ホームページ(<http://www.iot.ac.jp>)をご参照ください。
3. 講演申込締切：平成 21 年 6 月 5 日(金)
4. 講演論文締切：平成 21 年 7 月 3 日(金) (必着) [期日に遅れると講演論文集に掲載されないことがあります]
5. 講演申込について：
 - 1) 講演申込方法
 - (a) 大会運営効率化のため、ホームページ(<http://www.jsat.or.jp>)からの申し込みに限らせて頂きます。なお、コピーを保存しておいて下さい。
 - (b) 講演者(登壇者)は、原則として本会会員であることが必要です。
 - (c) 申込開始予定日は平成 21 年 4 月 6 日(月)です。
 - 2) 講演申込費：一件につき 2,000 円(参加費別途)が必要です。講演申込の受理後、請求書をお送りいたします。
 - 3) 講演募集分野：

オーガナイズドセッション(予定)

A. ラッピング・ポリシングの原理と応用	B. 半導体・液晶材料の加工計測技術	C. 超砥粒砥石・高機能砥石の開発と応用
D. 研削現象の基礎とモニタリング	E. 研削加工技術の最適化	F. ナノ精密・ELID加工
G. 噴射・パレル加工の最前線	H. マイクロ・ナノ加工	I. 加工シミュレーション
J. 超音波・振動援用加工	K. 環境調和型加工技術(含, MQL)	L. 新しい加工液と利用技術(含, メガソニック)
M. 難削材料・硬脆材料の加工	N. 切断・割断加工	O. 高性能切削工具の開発と応用
P. 加工機械の高性能・高機能化	Q. 超精密加工機とその要素技術	R. 先端計測技術
S. 機能表面の創成・処理技術	T. 磁界・電界砥粒制御による次世代加工技術	U. 光・ビームによる加工技術
V. 金型加工・放電加工の最新技術	W. 医歯学への応用	X. トライボロジー
Y. ものづくり技術教育	Z. ツールイング・ドレッシング技術と研削加工技術	

一般セッション

a. 砥粒加工技術	b. 工具技術	c. 加工機械技術
d. モデリング・シミュレーション	e. 切削加工技術	f. その他
6. 講演時間及び参加登録について
 - 1) 講演時間は、1講演 20 分(講演 15 分, 質疑応答5分)です。
 - 2) 講演者も講演会への参加登録が必要です。講演申込費とは別に講演会参加費をお支払いください。

講演会参加費は、正会員(賛助会員を含む)：3,000 円, 協賛団体会員：8,000 円, 非会員：20,000 円, 学生会員：無料、講演論文集は、1冊 会員(協賛を含む)：6,000 円, 非会員：12,000 円

当日申込の場合、それぞれ 500 円増しとなります。但し、協賛団体会員, 非会員は除きます。
7. 講演論文の執筆要領について(詳細は申込後にお知らせいたします)
 - 1) 頁数は、2, 4, 6 頁とします。ただし、「Y. ものづくり技術教育」は1頁も可です。
 - 2) 原稿の執筆および作成要領は、砥粒加工学会規定の「原稿作成要領」および「執筆要綱」を基本にしてください。

※ABTEC2009 に関する最新情報は、(社)砥粒加工学会ホームページ(<http://www.jsat.or.jp>)をご覧ください。
8. ABTEC優秀講演論文賞について：満 30 才以下の講演者を対象として、優秀な講演に対する 10 件程度の贈賞(2010 年 3 月の第 1 回通常総会を予定)を行います。
9. 問合せ先 (社)砥粒加工学会 〒169-0073 東京都新宿区百人町 2-22-17 セラミックスビル4F
TEL:03-3362-4195 FAX:03-3368-0902